

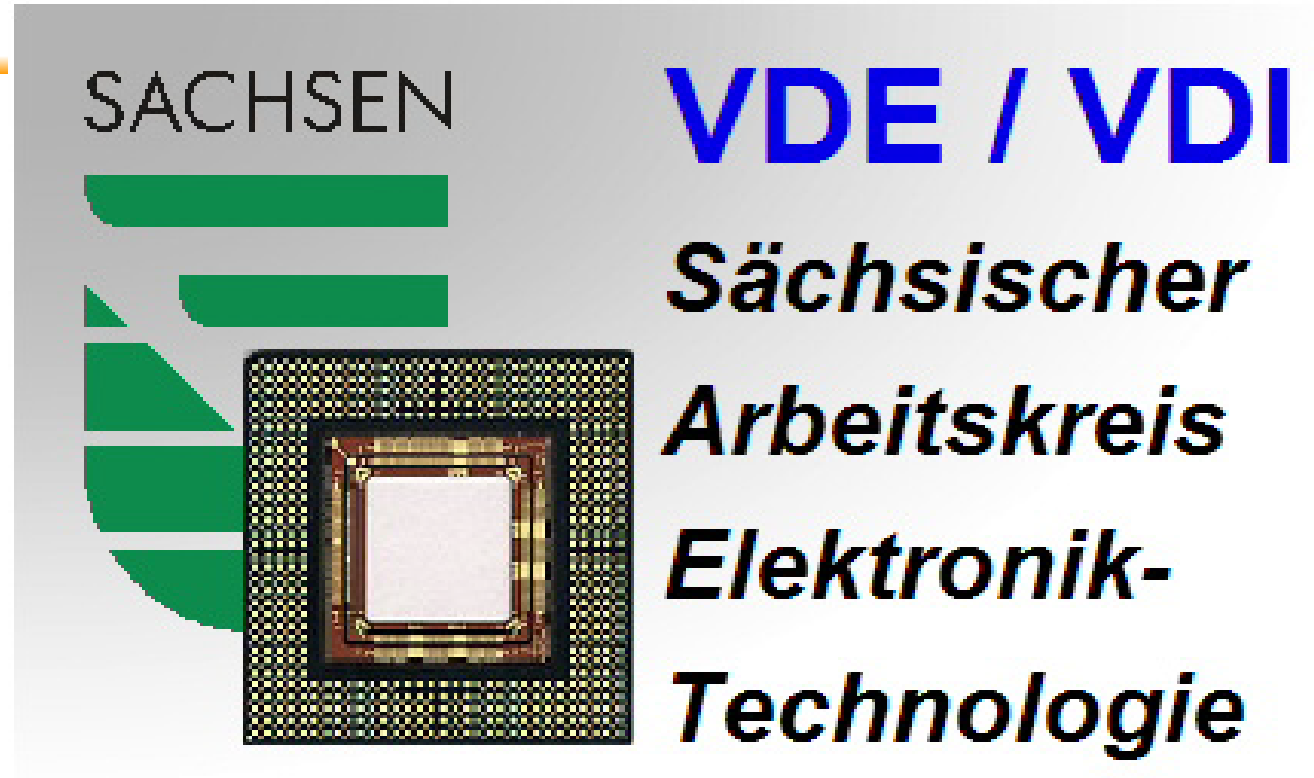
86. Treffen



am 15. April 2026

bei der KSG GmbH in Gornsdorf

Innovationen in der Leiterplattentechnik



86. Treffen

Kleiner Rückblick

24. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

am **Donnerstag, 15. Juni 2000** **10.00 Uhr**
bei der **KSG Leiterplatten GmbH in Gornsdorf**
Veranstaltungsort: Volkshaus Gornsdorf, Am Andreasberg 5 (ca. 500 m von KSG entfernt)

Thema: Neue Herausforderungen an die Leiterplattentechnik

Chairman: Dr.-Ing. Bechtloff Geschäftsführer der KSG Leiterplatten GmbH
Leitung: Prof. Sauer IET, TU Dresden
Organisation: Dipl.-Ing. Achim Süß Leiter Vertrieb/Produktentwicklung KSG
Dr. Bauer IET, TU Dresden

10:00 Uhr **Begrüßung der Teilnehmer**
Herr Prof. Sauer TU Dresden, Herr Dr. Bechtloff KSG

10:10 Uhr **Vorstellung der KSG Leiterplatten GmbH Gornsdorf**
Herr Dr. Bechtloff, GF der KSG Leiterplatten GmbH

10:35 Uhr **Entwicklung der Leiterplatte und ihre Trends in der Zukunft**
Herr Süß, KSG Leiterplatten GmbH

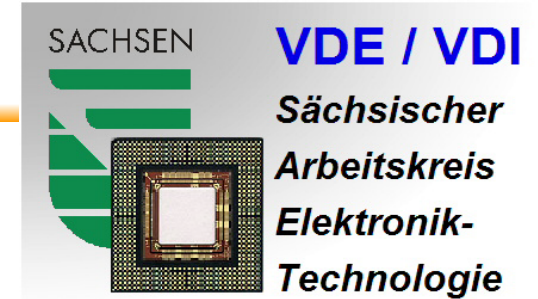
11:00 Uhr **Entwicklungstrends aus Sicht eines Basismaterialherstellers**
Herr Willuweit, Produktmanager Anwendungstechnik ISOLA

11:25 Uhr **Pause**

11:40 Uhr **Wie sehen optimale Fertigungsunterlagen aus?**
Herr Genz, KSG Leiterplatten GmbH

12:05 Uhr **Kostenbeeinflussende Faktoren**
Herr Haustein, KSG Leiterplatten GmbH

12:30 Uhr **Praktische Erfahrungen zur zerstörungsfreien Prüfung in der Flachbaugruppenfertigung**



44. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

am **Mittwoch, 29. Juni 2005** **10.00 Uhr**
bei der **KSG Leiterplatten GmbH**
Auerbacher Straße 3-5, 09390 Gornsdorf
Veranstaltungsort: Volkshaus Gornsdorf, Am Andreasberg 5 (ca. 500m von KSG entfernt)

Thema: Neue Herausforderungen an die Leiterplattentechnik

Leitung: **Herr Dr.-Ing. Bechtloff, GF der KSG Leiterplatten GmbH**
Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Fachbereich Elektrotechnik

10:00 Uhr **Begrüßung**
Herr Dr. Bechtloff, Herr Prof. Bauer

10:15 Uhr **Präsentation der KSG Leiterplatten GmbH**
Herr Dr. Bechtloff, KSG Leiterplatten GmbH

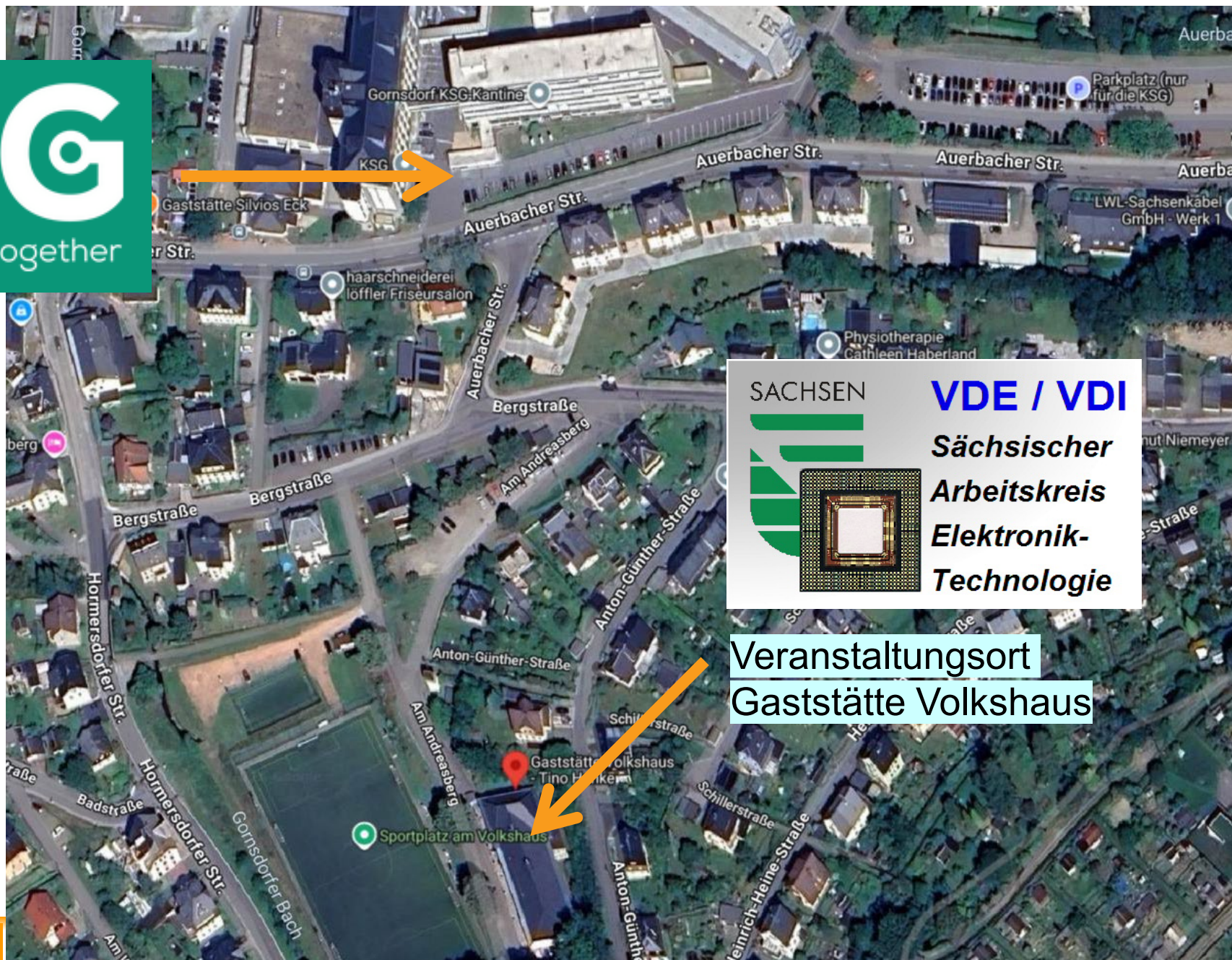
10:45 Uhr **Dickkupfer-Technologien in der Leiterplatte**
Herr Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH

11:45 Uhr **Integration optischer Layer in die Leiterplatte – Stand und Tendenzen**
Herr Dr. Schmieder, KSG Leiterplatten GmbH

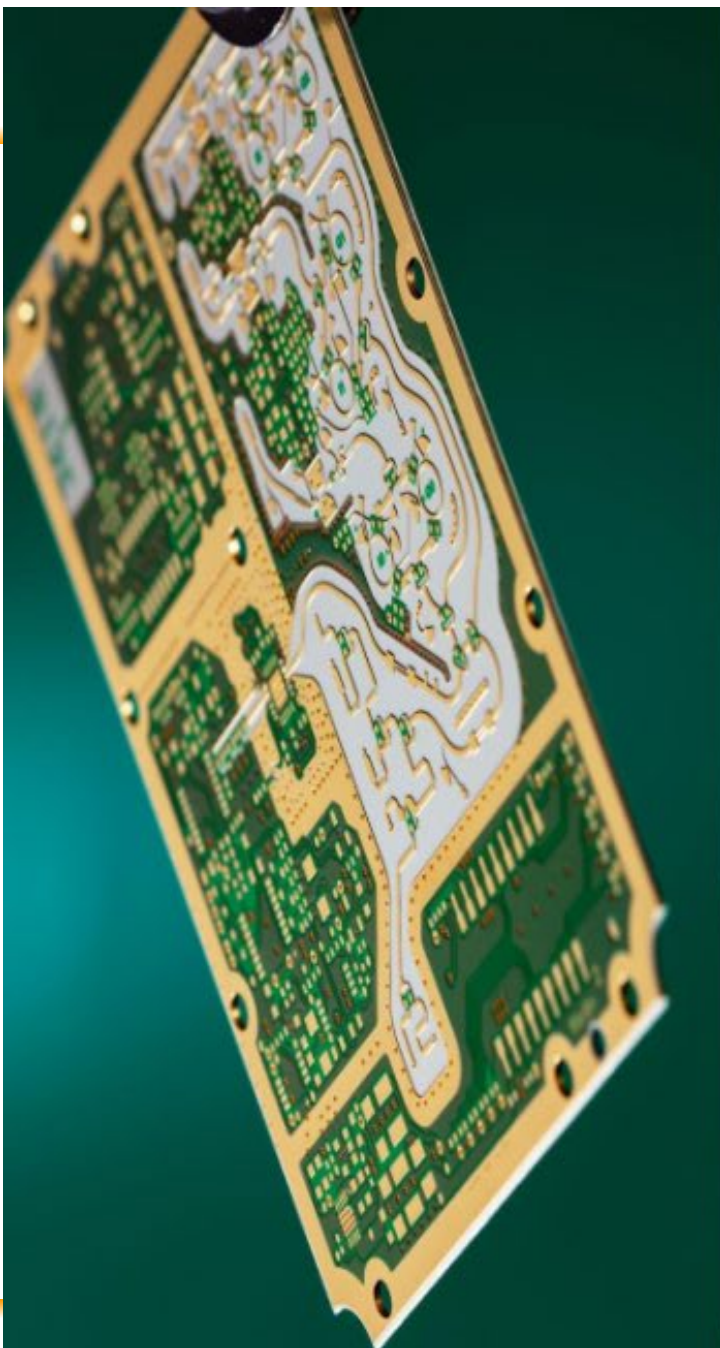
12:15 Uhr **Mittagspause**

13:00 Uhr **Aktuelle Anforderungen an Leiterplatten aus der Sicht der COB- Technologie**
Herr Schneider, Microelectronic Packaging Dresden GmbH

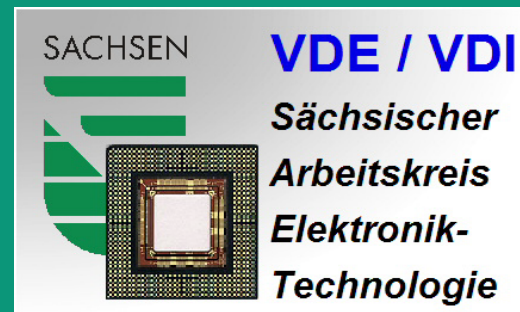
13:30 Uhr **Auswirkung des Designs auf die Herstellungskosten einer Leiterplatte**



Veranstaltungsort
Gaststätte Volkshaus



Agenda



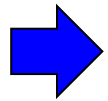
15. April 2026, 86. Treffen des Sächsischen AK Elektronik Technologie im VDE/VDI

Begrüßung	SAKET / Prof. Dr. Bauer	10:00 – 10:05 Uhr
KSG-Firmenvorstellung	KSG / S. Klöden, CEO	10:05 – 10:15 Uhr
Energieeffiziente PCB-Produktion: CO ₂ reduzieren, Kosten senken	KSG / S. Klöden, CEO	10:15 – 10:45 Uhr
Integration von Funktionalitäten in die Leiterplatte	KSG / R. Fiehler	10:45 – 11:15 Uhr
Kaffeepause		11:15 – 11:30 Uhr
Leiterplatten-Technologien der KSG im Überblick	KSG / S. Schädlich	11:30 – 12:00 Uhr
Mittagsimbiss		12:00 – 12:45 Uhr
Fertigungsrundgang		12:45 – 14:30 Uhr
Leiterplatten-Technologien für Hochfrequenzanwendungen	KSG / M. Schmied	14:30 – 15:00 Uhr
Low-Budget, High-Tech: Der Weg zur kostengünstigen Leiterplatte	KSG / J. Surma	15:00 – 15:30 Uhr
Informationen zum AK / Verabschiedung	SAKET / Prof. Dr. Bauer	15:30 – 15:45 Uhr

86. Treffen

Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie

Reinhard Bauer; Martin Oppermann



- **Vorschau zu den nächsten Treffen**
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**
- **Abschließende Anmerkungen**

Aktuelle Informationen und Anmerkungen

- Vorschau zu den nächsten Treffen 2026



87. Treffen am 25. November 2026

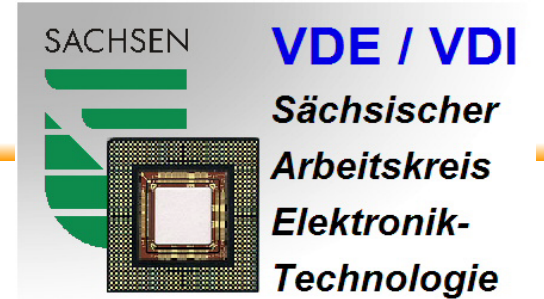
An der TU Dresden

**Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik IAVT und
Zentrum für Mikrotechnische Produktion ZmP**

In Dresden, Nöthnitzer Str. 63

Vorläufiger Titel:

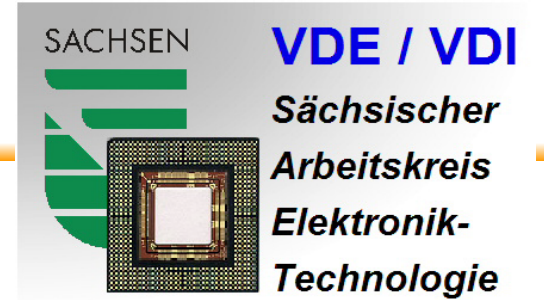
30 Jahre ZmP – Wegweisende Packagingforschung am IAVT & ZmP



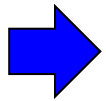
Veranstaltungsort Werner-Hartmann-Bau
Technikum für Technologien der Elektronik
Nöthnitzer Str. 66

86. Treffen

Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Reinhard Bauer; Martin Oppermann



- **Vorschau zu den nächsten Treffen**

87. Treffen am 25. November 2026

TU Dresden,
Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik IAVT und
Zentrum für Mikrotechnische Produktion ZμP

88. Treffen März / April 2027

Voraussichtlich im Großraum Dresden

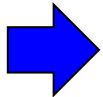
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**
- **Abschließende Anmerkungen**

86. Treffen

Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Reinhard Bauer; Martin Oppermann

- **Vorschau zu den nächsten Treffen**
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**



- In der PLUS 2/2026 ist ein kurzer Bericht zum 85. Treffen des SAK ET erschienen

- Ein offenes Wort zur Organisation:

Die Gestaltung der Treffen des Arbeitskreises wird natürlich sehr stark von den Möglichkeiten der Gastgeber beeinflusst. Dabei ist die Teilnehmerzahl durch die Anzahl der Plätze in den Beratungsräumen und durch die Möglichkeiten einer Fertigungs- bzw. Laborführung begrenzt.

Deshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung der Teilnahme unbedingt erforderlich und AUCH EINE BESTÄTIGUNG DER TEILNAHMEMÖGLICHKEIT von uns unbedingte Notwendigkeit, um wirklich teilnehmen zu können.

Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen und zu akzeptieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Aktuelle Informationen und Anmerkungen

**Für Anregungen, Angebote, Meinungen, Ideen, Hinweise
bitte eine E-Mail an uns**

Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
E-Mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de

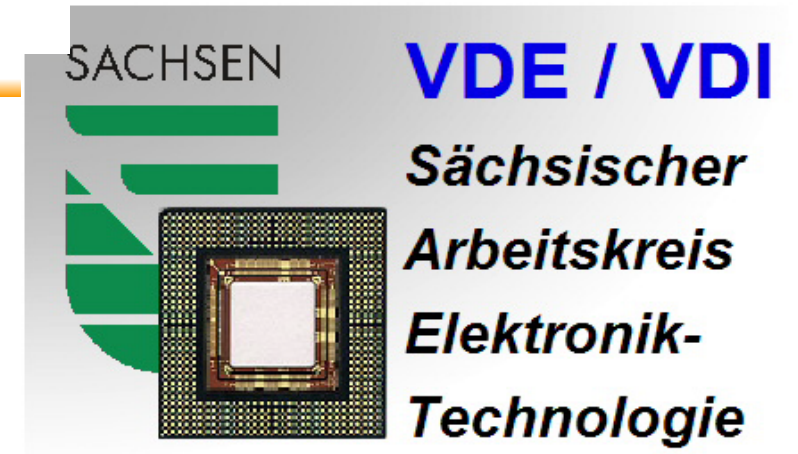
Koordinator: Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann,
TU Dresden, IAVT / Z μ P
E-Mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

**Informationen veröffentlichen wir unter
<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>**

Hinweise:

Bitte an die Referenten, ihren Beitrag als PDF für die Veröffentlichung auf der Home Page des Arbeitskreises (je nach Freigabe) zur Verfügung zu stellen.

Fotos während der Veranstaltungen werden teilweise zu Veröffentlichungen des Arbeitskreises genutzt.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Ganz herzlichen Dank an
die KSG GmbH,
insbesondere Frau Gleiniger (CEO, CFO) und Herrn Klöden (CEO, CTO),
dass die Veranstaltung heute hier möglich war und die sehr freundliche Aufnahme,
ein besonderer Dank an Herrn Fiehler, dass er die Organisation bei KSG übernommen hat
und an alle seinen Kolleginnen und Kollegen, die alles vorbereitet und gestaltet haben.

Vielen Dank auch an alle Referenten für die interessanten Beiträge und Diskussionen und
auch an alle, die die Fertigungsführung gestaltet haben.

Allen Teilnehmern ebenfalls ein Dankeschön für das rege Interesse!

Wir freuen uns auf die nächsten Treffen -
Über weitere Angebote als Gastgeber und Referenten freuen wir uns immer!